

# 微細パターン可能で 高電圧や高熱・放熱に耐える

High resolution & 3 High Resistances:  
High voltage isolation / Thermal / Heat dissipation



## Photo Imageable Dielectric Material for Semiconductor RD-100 A01L

### 特長 Features

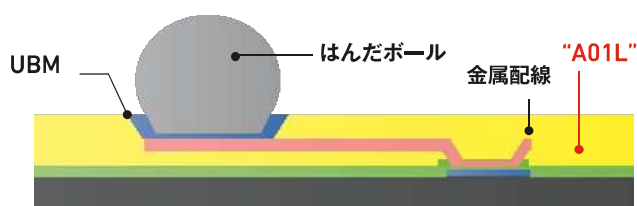
- **ポジ型液状タイプ**  
Positive Liquid Type
- **高解像性**      **ー アスペクト1以上の高い解像性を有しています ー**  
High resolution      **ー RD-100 A01L can form fine pattern ー**
- **高い信頼性**      **ー 優れた薬品耐性とB-HAST耐性を有しています ー**  
Good reliability      **ー RD-100 A01L show high chemical resistance and B-HAST resistance ー**

### 特性 Properties

パターニング条件(めっきCu)	パターニング条件(スパッタCu)
スピコート : 2200rpm	スピコート : 2200rpm
プリベーク : 110°C/3.5min	プリベーク : 110°C/3.5min
露光 : 500mJ/cm(i-line)	露光 : 500mJ/cm(i-line)
現像 : 35s バトル(2.38%TMAH aq. 23°C)	現像 : 40s バトル(2.38%TMAH aq. 23°C)
硬化 : 150°C/30min+220°C/60min(N2)	硬化 : 150°C/30min+220°C/60min(N2)

### 用途 Application

WLP再配線用絶縁膜 (RDL)



Substrate	$\phi = 6\mu\text{m}$		
Plated Cu			
Sputtered Cu			